

苏州东微半导体股份有限公司

关于 2026 年“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

为积极响应落实关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护全体股东合法权益，牢固树立回报股东意识，切实增强投资者回报与获得感，推动公司高质量、可持续发展。苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月披露《关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。根据行动方案内容，公司在 2026 年上半年积极推进相关工作，现将行动方案半年度执行情况报告如下：

一、聚焦主业发展，持续提升经营质量

公司是一家具备从专利到量产完整经验的技术驱动型半导体企业，产品覆盖高性能功率器件、功率模块、数模混合电源管理芯片、数字实时控制器等。公司致力于围绕信号采集、逻辑控制、功率输出等环节，构建完整的“控制—驱动—执行”全链路解决方案，助力算力能源基础设施、新能源电力系统、汽车电子及工业控制等下游客户实现一体化系统应用落地。报告期内，公司积极把握市场机遇，持续加大研发创新投入，巩固核心竞争优势。

（一）经营业绩稳步增长

报告期内，公司实现营业收入 7.36 亿元，同比增长 19.58%；归属于上市公司股东的净利润 10,630.18 万元，同比增长 285.41%；基本每股收益 0.87 元/股，同比增长 278.26%。

报告期内，公司完成收购深圳慧能泰半导体科技有限公司（以下简称“慧能泰”）控股权，深化与慧能泰的并购整合，促进业务、技术、研发、运营、供应链和职能体系的进一步融合。根据相关会计准则，慧能泰于 2026 年 5 月起纳入公司合并报表范围，并在纳入合并报表范围期间实现营业收入 4,330.48 万元、净利润 227.94 万元。

（二）研发投入持续增加

2026 年上半年，公司聚焦半导体高性能功率半导体及数字控制 IC 的研发和销售，坚持研发投入，积累并优化技术储备，加快实现新产品的技术迭代。公司 2026 年 1-6 月研发费用投入 5,565.28 万元，较上年同期增加 1,342.23 万元，同比增长 31.78%。本期末研发人员数量 113 人，较上年同期增长 36.14%。与此同时，公司高度重视研发人才梯队建设，通过外部招聘和内部培养双通道，持续扩大技术团队。

在专利布局方面，截至 2026 年 6 月底，公司累计获得授权专利及软件著作权 111 项。其中发明专利 103 项，实用新型专利 7 项，公司已登记软件著作权 1 项。报告期内，公司新增知识产权申请项目 13 个，其中境内发明专利申请数 7 个，集成电路布图 6 个；新增知识产权授权项目 15 个，其中境内发明专利 7 个，境外专利 4 个，集成电路布图 4 个。

（三）产品品类持续扩张

报告期内，公司持续进行新技术开发工作，持续推进产品升级和技术迭代。同时与控股子公司慧能泰进行技术合作，搭建完整的数字 IC 矩阵，覆盖数模混合快速充电控制芯片、数字电源控制器、工业实时控制 DSP、高精度 BMS AFE、PMIC、栅极驱动、模拟运放等全品类芯片，包含了更多的产品品类和更多的应用领域。

1、功率器件/功率模块：

超级结 MOSFET 方面，报告期内公司第四代超级结 MOSFET 产品出货比例保持稳步增长，同时第六代超级结 MOSFET 研发工作取得阶段性重要进展，验证结果符合预期。公司将持续推进耐压范围拓展，全电压段超结产品布局进一步完善。

中低压屏蔽栅 MOSFET 方面，报告期内公司通过对 25V-200V 全规格段中低压屏蔽栅产品性能进行深度优化，成功量产了多颗高难度规格产品，为客户的国产化替代提供了坚实支撑。其中，40V FSMOS 系列实现了从 8 英寸到 12 英寸产线的全面迭代；150V-200V 平台凭借新开发的独特技术，成为通信与服务器电源等高频应用的理想选择。同时，公司全力推进 25V-200V 下一代高速系列器件，达

成更低的比导通电阻，更小的电容，更快的开关速度，致力于在高端电力电子装备等前沿应用领域创造更大价值。

独创结构的 TGBT 方面，报告期内公司完成了基于柔性开关技术的 650V 高速低功耗 TGBT 产品的研发，在相关客户（含汽车领域）已经完成初步评估，性能满足预期，公司研发的多款高电压 TGBT 已批量交付工业电机及光伏逆变客户。

SiC 器件方面，报告期内公司第二代、第三代 650V 和 1200V 平台的多个 SiC MOSFET 产品已通过严苛的工业级可靠性验证，进入稳定交付阶段，并成功切入行业头部客户供应链，覆盖服务器电源、光伏储能、车载充电机等核心应用场景。1400V 及更高电压产品已通过客户测试并获得订单，该系列产品是工业高压电源、固态变压器、储能变流器等高端场景的核心器件。650V/750V/1200V 第四代 SiC MOSFET 平台已完成研发进入量产爬坡阶段，性能处于国内领先水平；同时，3300V 及以上系列产品也在积极研发布局中。

功率模块方面，报告期内公司模块产品已批量出货，产品聚焦储能、AIDC 等大功率密度场景，并针对机器人领域进行小型化低压模块的开发。其中在高压领域，公司产品可广泛应用于新能源汽车 OBC/DCDC、光伏逆变器、储能系统及算力服务器 AIDC 领域；在低压领域，公司低压 SGT MOS 半桥/全桥模块系列产品涵盖绿色能源与通信领域的高性能同步整流电源、特种交通工具如电动快艇及四轮低速电动车的驱动系统、无人机飞控电源及四足机器人关节驱动模组，以及汽车热管理系统。

2、IC 产品方面

数模混合快速充电控制芯片主要应用在消费电子的旅行充电器、车载充电器、快充线缆、各类移动式快充设备中。在报告期内，公司对现有优势产品持续迭代，将在单快充端口中应用较为成熟的零外围极简方案扩展到多端口应用场合，进一步加强了产品组合的竞争力。同时，针对主流快充协议 USB PD 的变更升级，公司也推出了新一代产品，持续为客户提供最佳性能的解决方案。

数模混合开关电源控制芯片主要面向工业类场景的 PC 电源、充电机、服务器电源、中间母线变换器等应用。报告期内，基于上一代产品的反馈，对于分别

适用于图腾柱无桥 PFC 拓扑和交错 PFC 拓扑的 ACDC 数字控制器进行了升级优化，提升了产品在 EMC 性能、动态响应等方面的关键指标，进一步增强了产品竞争力。同时，在 DCDC 数字控制器产品方面，首次推出了 AI 数据中心 48V 供电环节下覆盖硬开关全桥、开环 LLC 多相 Buck 等主流拓扑的数字控制器产品，并给部分行业领先客户送样测试。

工业实时控制 DSP 方面，产品对标国际大厂，主要面向电源和电机控制应用。产品的数字架构、硬件加速电路和专用接口全自研，新一代产品支持私有协议的工业实时总线。

辅助电源方面，公司在第三代半导体器件领域的技术积累基础上，积极推进面向车载及 AI 算力电源的 800V 辅助电源芯片系列的研发工作。车规级辅助电源适用于新能源汽车主驱辅助电源及高压 DC/DC 内部辅助供电；AI 用辅助电源针对 800V 高压母线输入场景进行了高压启动及高功率密度专项优化，为 AI 服务器电源系统提供小体积高可靠性的辅助供电。

二、完善公司治理，强化规范运作

（一）制定薪酬管理制度

报告期内，公司制定并完善《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，严格落实“基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励”三元薪酬架构，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总和的 50%。董高薪酬水平综合参照市场薪酬行情、公司整体经营成果及个人履职表现确定，同步设置绩效递延支付、薪酬追回机制，对违规失职、财务错报情形明确薪酬扣减、追回约束条款，压紧压实关键少数责任与履约意识，以规范化薪酬制度约束激励机制，切实保障公司及全体股东权益。

（二）提升关键少数履职能力

报告期内，公司实际控制人严格恪守合规底线，不存在占用公司资金、侵占公司资产、违规干预公司经营、损害公司及中小股东合法权益的情形，在业务、人员、资产、财务等方面始终与公司保持完全独立。公司依托独立董事、董事会审计委员会等监督机制，对“关键少数”履职行为、重大经营决策、重点治理领域实现有效制衡与监督。公司持续组织、鼓励“关键少数”参与监管机构和行业

自律组织举办的各项培训，常态化开展履职能力提升工作，夯实董高专业履职能力。

三、提升信息披露质量，树立资本市场良好形象

公司自上市以来十分重视投资者交流沟通工作，建立了多元化投资者交流沟通渠道，致力于保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，增强信息透明度和管理规范性。

2026年3月30日，公司组织了特定对象调研，公司管理层通过电话会议的方式，与近40家机构就公司收购深圳慧能泰半导体科技有限公司控股权进行充分交流。

2026年5月11日，公司通过进门财经平台召开了2025年度暨2026年一季度业绩交流会，公司董事长兼总经理、董事会秘书针对公司2025年业绩与财务指标进行详细解读，并针对投资者关心的热点问题展开充分交流。

2026年上半年，公司投资者关系管理工作稳步推进，及时通过上证E互动平台答复投资者提问。在此基础上，公司持续通过分析师交流、投资者热线及邮箱等渠道，与投资者保持密切沟通，主动、清晰地向市场传达公司战略、经营与财务情况，并注重收集、反馈投资者的意见建议，促进管理层及时了解市场关切，提升决策科学性和公司透明度。

四、提高股东回报，增进市场认同

公司自上市以来，高度重视对全体股东的分红回报，连续五年进行利润分配。2026年7月8日，公司完成2025年度权益分派，以公司总股本122,574,975股为基数，每股派发现金红利0.0754元（含税），合计派发现金红利9,242,153.12元（含税），此次现金分红金额占2025年归属于上市公司股东净利润的比率为20%。

公司将继续秉持审慎原则，统筹考量实际经营需要与长远战略布局，科学平衡企业可持续发展与投资者回报诉求。在严格遵守相关法律法规及《公司章程》利润分配规定的前提下，公司将精准协调资本开支、日常运营资金与现金分红的关系，致力于构建并完善“科学、长期、稳定、可持续”的股东回报体系，将保

障投资者特别是中小投资者的合法权益落到实处，以切实行动回馈市场的信任与托付。同时，公司将持续强化盈利能力与核心竞争力，立足股东中长期利益，让股东切实分享公司成长的红利，不断提升投资者的获得感与幸福感。

五、其他事项

2026 年上半年，公司在行动方案的指引下，各项工作稳步推进，取得了一定的阶段性成效。未来，公司将持续聚焦主业经营，完善治理体系，提升信息披露质量不断强化公司的核心竞争力与市场影响力，为全体股东创造更大价值，为公司的可持续发展奠定坚实基础。

本评估报告系基于公司目前实际经营情况所做出的判断，所涉及的公司规划、发展战略及相关预测未来可能受到政策调整、市场环境等多种因素的影响，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

苏州东微半导体股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日